

Mini-MOSシリーズ/L-MOSシリーズ

Mini-MOS Series / L-MOS Series

超小型パッケージ製品群 Mini-MOSシリーズ/L-MOSシリーズ

■ 世界最小・最薄パッケージ Mini-MOSシリーズ

近年、情報通信機器の小型化に伴い、半導体デバイスはより小さく、より薄く、かつアセンブリの容易なパッケージへの要求が強まってきました。

それらの要求に対し東芝では、従来のDIP、SOP、TSSOPパッケージで提供してきた製品をUS16(16ピン)、US20(20ピン)の超小型パッケージに搭載して提供しています。

Mini-MOSシリーズの特長

- **世界最小パッケージ**(16/20ピンクラス)
実装面積: 16mm²(16ピン)、20mm²(20ピン)
- **世界最薄パッケージ**(16/20ピンクラス)
全高: 1.0mm MAX
- **容易な基板への実装**
0.5mmのリードピッチ採用により基板への実装を容易にします
- **高品質・高信頼性**
IRリフロー対応可/防湿梱包無し
- **幅広いラインアップ**
91品種のワイドラインアップ

■ シリアルE²PROM TC9WMシリーズ

ID、セキュリティ機能、補正用データなど、小容量のデータ保持、蓄積に用いられる1KビットシリアルE²PROMを業界最小・最薄パッケージUS8で実現しました。

携帯電話やPDA、小型タグなど携帯情報端末の小型化に貢献します。今後、シリアルE²PROMシリーズとして、2Kビット製品など、順次、品種展開していきます。

- 1kビット(128×8ビット)のメモリ保持
- シリアルデータ入出力
- 単一電源(昇圧回路内蔵)
- 低消費電流、スタンバイ時: 1μA
- プログラム時間の自動設定(10ms)

■ 新開発 L-MOS AHSシリーズ US6パッケージ

低電圧動作、超高速動作のAHSシリーズをUS6パッケージに搭載しました。

- パッケージサイズ: 2.0×1.25×1.1mm
- 3.3V時の最大伝搬遅延時間2.8nsとL-MOSシリーズ最速
- 3.6V入出力トレラント機能、およびパワーダウプロテクション機能付き
- 2.5V/3.3V混在システムでの使用が可能
- 電気的特性はTC74VCXシリーズ相当
- ラインアップ: インバータ、マルチプレクサなど7品種

■ Mini-MOS / L-MOSパッケージ

